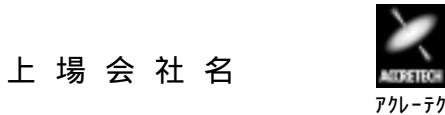




平成 17年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 16年 11月 12日



株式会社東京精密

上場取引所 東

コード番号 7729

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.accretech.jp/>)

代表者 代表取締役会長 C.E.O. 大坪 英夫

問合せ先責任者 代表取締役業務会社執行役員社長 太田 邦正 TEL (0422) 48 - 1011

中間決算取締役会開催日 平成 16年 11月 12日

米国会計基準採用の有無 無

1. 16年 9月中間期の連結業績(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16年 9月 30日)

(1)連結経営成績 (百万円未満は切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 9月中間期	45,340	75.0	8,157	506.2	8,295	728.5
15年 9月中間期	25,909	10.8	1,345	249.6	1,001	-
16年 3月期	62,324		5,947		5,328	

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
16年 9月中間期	4,454	-	119	07	108	95
15年 9月中間期	259	-	6	93	6	93
16年 3月期	3,783		101	67	-	

(注) 持分法投資損益 16年 9月中間期 - 百万円 15年 9月中間期 - 百万円 16年 3月期 - 百万円
 期中平均株式数(連結) 16年 9月中間期 37,408,547 株 15年 9月中間期 37,355,775 株 16年 3月期 37,355,470 株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

	総資産		株主資本		株主資本比率		1株当たり株主資本	
	百万円		百万円		%	円	銭	
16年 9月中間期	98,311		33,530		34.1	894	21	
15年 9月中間期	90,311		33,621		37.2	900	05	
16年 3月期	94,893		29,183		30.8	780	87	

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年 9月中間期 37,497,268 株 15年 9月中間期 37,355,311 株 16年 3月期 37,354,830 株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー		投資活動による キャッシュ・フロー		財務活動による キャッシュ・フロー		現金及び現金同等物 期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
16年 9月中間期	5,554		857		6,847		10,149	
15年 9月中間期	970		923		1,145		7,376	
16年 3月期	4,569		167		1,662		12,242	

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 0 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)0 社 (除外)0 社 持分法(新規)0 社 (除外)0 社

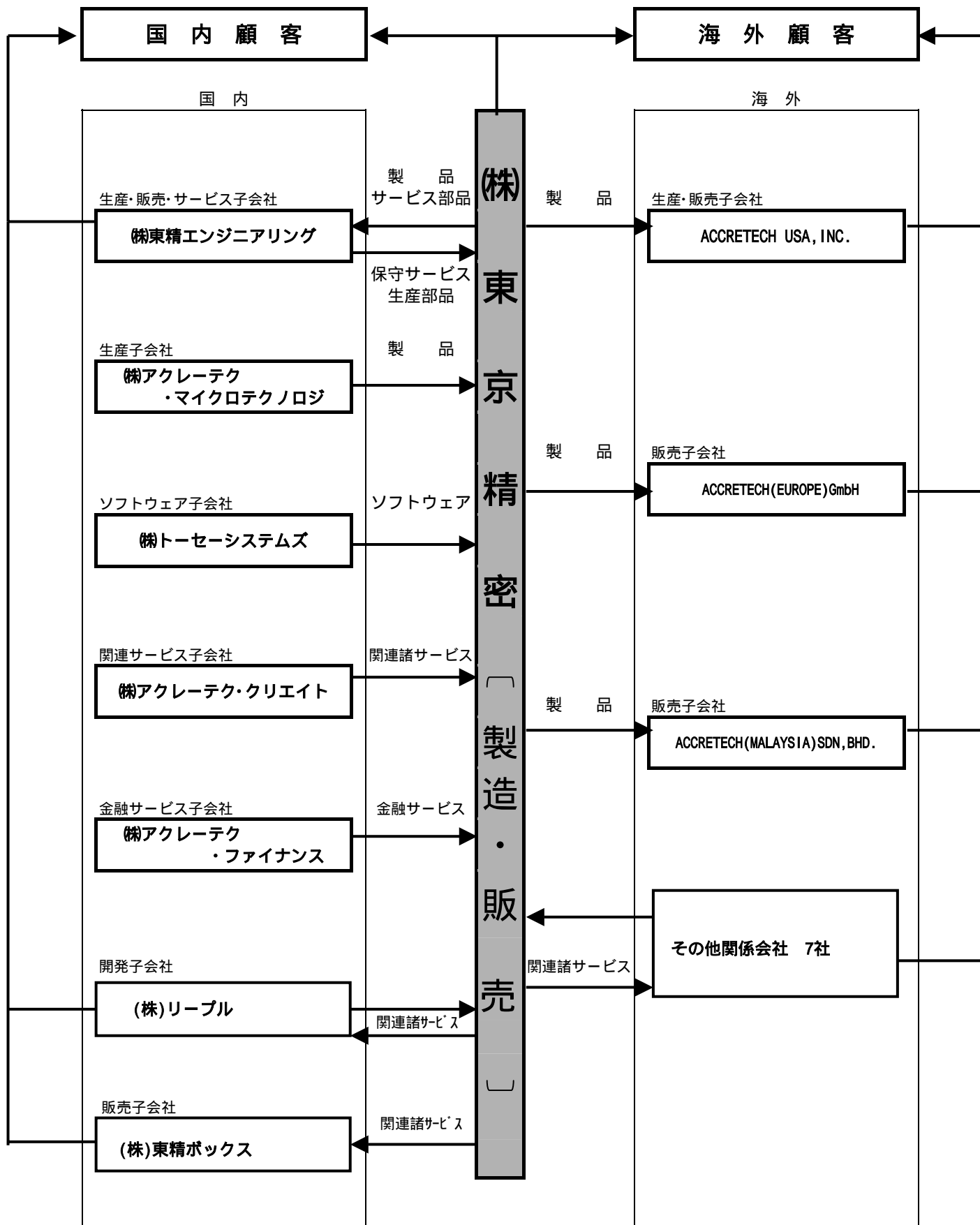
2. 17年 3月期の連結業績予想(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17年 3月 31日)

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円		百万円		百万円	
通期	81,000		13,500		7,000	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 186 円 90 銭

上記の予想は、添付資料8,9ページの通期の見通しを前提としております。

1 . 企業集団の状況



2 . 経営方針

(1) 基本方針

当社は、精密計測機器および半導体製造装置メーカーとして、常にお客様の高生産性に寄与する最先端技術を駆使した製品開発とカスタマーサポートに注力してまいりました。技術革新が高レベルかつ高スピードで進行する環境下、当社が発展し続けるために最も重要な事は、強い製品開発体制と適正な製品開発基準を持つことです。そこで、以下に掲げる「製品開発の原則」を当社の経営の大原則として、市場の設備投資動向の影響を最小限に抑えつつ、高成長・高収益のビジネス基盤を構築し、さらなる企業価値向上に努めております。

「製品開発の原則」

世界 No.1 の製品を創る

マーケットシェア No.1 の商品は、

(a) 好況時の利益の極大化がはかれる

(b) 不況時の損失の極小化がはかれる

研究開発投資は自己資金で

技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う

相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する

また、「WIN - WIN の仕事で世界 No.1 の商品を創ろう」を当社の行動指針として制定し、「製品開発の原則」遵守を徹底して推進しております。世界 No.1 の製品開発には、各分野における最先端の技術とスピードが要求されます。そのためには、当社の培ってきたコア・テクノロジーを応用することに加え、国内外の垣根を越えて、世界 No.1 の製品創りという共通目的をもつ会社および個人と“WIN - WIN”の協力関係を築くことが不可欠です。各国、各社のもつ異文化を融合したグローバルかつハイブリッドな社風を醸成することにより、世界 No.1 の製品開発体制を構築して、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しております。

当社のコーポレートブランド「ACCRETECH (アクレーテック)」は、「ACCRETE (= Grow Together の意味) + TECHNOLOGY」の合成語で、世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界 No.1 の商品を創り、皆様とともに大きく成長していくという当社の企業理念を一語で表わしたものです。

(2) ユニークな開発体制

当社は、1988 年より各技術開発グループを製品群別に分け、グループリーダーをヘッドとするグループリーダー制を採用しています。グループリーダーは、製品開発のみならず、担当する製品群の業績全般についての責任をもち、事業計画作成、設備投資および人材の採用など大きな権限を与えられています。

2002 年 4 月、当社の執行役員制導入に伴い、グループリーダーは、執行役員に選任されました。これにより、グループリーダー制の備えている、開発計画などのスピーディな意思決定や市場動向への迅速・柔軟な対応という長所が一層強化されました。

(3) 利益配分に関する基本方針

当社は、成長分野において、最先端技術を駆使した世界 No.1 商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様へ利益還元を図ってまいります。配当につきましては、将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、株主の皆様の長期的視点を重視した安定的な配当を実施してまいりたいと考えております。

内部留保金につきましては、当社が成長していくために不可欠な研究開発投資、生産設備投資などに有効に活用してまいりたいと存じます。

(4) 目標とする経営指標

当社は、株主の皆様が当社株式を所有する目的に沿った経営を行っております。従って、一株当たり利益の長期的な上昇とその結果としての企業価値の長期的な上昇を、経営上の重要な指標と考えています。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、前記の基本方針・開発体制に基づき、「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」・「CMP 装置」および「LEEPL 転写装置」など、技術参入障壁が高く競争が少なく、マーケットも大きい、高機能・高価格の新規参入製品を開発してきました。これらの新規参入製品は、いずれも当社従来製品に比して、数十倍も高い価格の製品であります。

「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」は 2000 年度に、「CMP 装置」は 2002 年度に夫々市場投入しましたが、その後お客様の評価は年々たかまり、ビジネスとして順調に成長しています。これら半導体新規参入製品の当中間期の売上高は 71 億円と前中間期比 47% 増を達成いたしました。「LEEPL 転写装置」は、来年度以降の市場投入を予想しています。

半導体および半導体製造装置の今後の市況は、短期的には一時的な調整はあるものの、中期的には好況期が続くと予想されています。かかる状況下、当社は新規参入製品の売上拡大と利益率向上をさらに推進し、出来るだけ早い時点での、売上高および利益の既往ピーク更新を目指しています。

さらに、より長期(10年以上)のことを考えますと、当社の従来製品(マシンコントロールゲージ、表面粗さ測定機、真円度測定機、三次元座標測定機、プロービングマシン、ダイシングマシンなど)が、将来、中国製品と競争する厳しい状況におかれることも想定しておく必要があります。当社は、高機能・高価格で競争の少ない新規参入製品の開発は、長期的な対中国シフトの観点からも重要と考え推進しているものであります。

(6) 会社の対処すべき課題

新規参入製品事業の成功

当社は、ここ数年来、半導体新規参入製品の開発を積極的に進めてきましたが、「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」は、ビジネスとして軌道に乗り、予定通りマーケットシェアを拡大しておりますし、「CMP 装置」につきましても顧客開拓が進んでいます。これらによる新規参入製品の売上高は、計測部門に匹敵する規模になりました。

今後は、これらの新規参入製品の事業基盤の強化を図り、売上および利益をより一層拡大させることが重要と考えています。

財務構成の改善

当社は、当中間期の業績が好調に推移したことで新規参入製品の売上が伸長したことにより、自己資本比率や資産回転率などの財務諸比率を着実に改善することができました。

新規参入製品の販売が拡大している成長期の当社の場合、今後 1~2 期は、財務諸比率の緩やかな改善を甘受しなければなりません。数年後には、新規参入製品の売上・利益の拡大によるフリーキャッシュフローのプラスと昨年 10 月に発行した転換社債型新株予約権付社債の資本への転換により、財務諸比率が格段に良くなる見通しです。

なお、2005 年度の減損会計適用、2007 年度の国際会計適用についても準備を進めてまいり所存です。

(7) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその施策の実施状況

<コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方>

企業の経営環境が目覚ましい変化を遂げる中、持続的な成長と発展を実現するには、その変化のスピードに対応できる経営体制の構築と、経営の国際標準化および株主重視経営に適合したコーポレートガバナンスの充実が不可欠と認識しております。

株主の権利の保護と平等な扱いに留意するとともに、他のステークホルダーとの円滑な関係の構築にも注力しております。今後とも、適切な情報開示と透明性確保を図り、取締役会と監査役会の機能発揮によるコーポレートガバナンスの実行性確保に注力してまいります。

<コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況>

執行役員制とカンパニー制の導入

当社は、2002年4月に執行役員制と社内カンパニー制を導入し、社内を半導体社、計測社、業務会社の3つのカンパニーに分けました。全てのオペレーションは、この3社で行うこととし、head officeとしての機能は廃止いたしました。

半導体社と計測社は、完結した組織として、夫々のお客様に一層機動的かつ迅速に対応できるように、業務会社は、間接部門の合理化を推進しております。

また、2003年4月にトップマネジメントを改正し、会長C.E.O.と社長C.O.O.を分離いたしました。会長C.E.O.は中長期の経営戦略に係わるものに専念し、日常の業務は各カンパニーの社長に委譲され、社長C.O.O.が全社的な業務執行責任を負うこととなり、経営執行体制がより明確になりました。

コーポレートガバナンスの実効性確保

A．社内カンパニー制の導入に伴い、株式会社東京精密は、理論的には取締役会のみになります。取締役会は、会社の重要な業務執行について決定したり、取締役の職務執行を監督する機関ですが、当社の取締役は出身企業が多岐にわたり、様々な会社で経験を重ねた人が取締役会を構成しており、当社の取締役会はハイブリッドな組織となっております。

B．当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役は、当社の大株主出身の経営者と有識者で構成されおり、現在4名のうち3名が社外監査役であります。当社の監査役は、報酬委員会および経営諮問委員会のメンバーを兼務し、役員の報酬その他、経営の妥当性の判断も行っています。

C．以上のように当社の取締役会および監査役会のシステムは、日本、米国、ドイツのコーポレートガバナンスの長所をミックスした制度になっています。従って、当社のコーポレートガバナンスは、極めて透明性が高く、accountabilityが明確であります。

3．経営成績および財政状態

(1) 経営成績

当中間期の概況

[業績全般]

当中間期の半導体業界は、カメラ付携帯電話を始めとするデジタル・コンシューマ機器の好調やパソコンの需要堅調などにより、前年度下期からの好調を継続しました。半導体各メーカーは、生産・販売を伸ばし、設備投資も積極的に推進しています。

これを反映して、当社半導体製造装置部門の市況も極めて好調に推移し、半導体既存製品、半導体新規参入製品とも前中間期比大幅な増収・増益となりました。

計測機器部門につきましても、国内市況が日本経済の景気上昇の下、自動車産業や10年来の好況局面に入った工作機械業界向けなどに好調に推移し、輸出も中国をはじめとするアジア向けを中心に伸長したことから、前中間期比増収増益を達成しました。

この結果、当中間期の連結受注高は469億29百万円（前中間期比69.5%増）、連結売上高は453億40百万円（同75%増）、連結経常利益は82億95百万円（同8.2倍）、連結当期純利益は44億54百万円（同17.1倍）となり、半期業績としては、過去最高の売上・利益を達成しました。

[各部門の概況]

A. 半導体製造装置部門

(a) 半導体製造装置部門につきましては、国内外の半導体メーカーの積極的な設備投資動向を的確に捉え、ニーズに応えるきめ細かい営業を展開しました結果、当中間期の受注高は、384億88百万円（前中間期比94%増）、売上高は366億91百万円（同97.6%増）と大幅増収となり、過去最高を達成しました。

利益面では、売上の増加の一方で、内製比率のアップによる変動比率引き下げや固定費増の圧縮などのコストダウン施策を展開した結果、61億92百万円の営業黒字を計上し、前中間期比大幅改善となりました。

(地域別の状況)

地域別に見ますと国内、韓国、台湾および北米が好調で前中間期比大幅に伸長しています。中国も着実に需要が増加し、売上が拡大しており、今後が期待されます。

(製品別の状況)

ウェーハプロ・ピングマシンにつきましては、最先端デバイス向け高精度プローバに対する更新需要と300mm対応の新規需要が急増しており、受注、生産、売上が大きく伸長して過去最高となり、No.1プレーヤーとしてマーケットシェアを着実に伸ばしています。

300mmウェーハ対応の第三世代機となる最新鋭機種「UF3000」は、システムLSIなどの多品種少量生産から、メモリなどの大量生産まであらゆるデバイスメーカーのニーズをカバーするフルオートタイプの超高性能プローピングマシンとして、お客様から高い支持を得ており、販売が大幅に増加しています。

ウェーハダイシングマシンにつきましても、当社製品に対する評価が高く、新規顧客も増加し、マーケットシェアが拡大した結果、当中間期の受注高および9月末受注残高は、過去最高となりました。

300mm対応の「A-WD-300T」は生産性の高いマシンとしてお客様からの評判が高く、受注、売上が前中間期比急増しています。

また、開発を進めてきた新型レーザーダイシング装置「MAHOHDICING MACHINE」は、当中間期に初めて出荷され、売上計上となりました。

ウェーハ外観検査装置では、「WIN-WIN50」の持つ強みである、低いCost of Ownershipや高い検出率などが高く評価され、既存ユーザーからリピートオーダーを頂くとともに、新規ユーザーも獲得しています。また、当社と株式会社日立ハイテクノロジー・ズが共同開発したDeep Ultra Violetタイプの「HA3000」も揃え、多岐にわたるユーザーニーズに応えており、マーケットシェアを着実に伸ばしています。

ポリッシュ・グラインダは、ウェーハの薄片化とダメージ除去を1台で実現している、他に追随を許さない当社独自の製品で、ウェーハ薄片化市場におけるデファクトスタンダードとなっています。300mm対応の「PG300」を中心に、受注・売上とも前中間期比倍増し、過去最高となっています。

また、CMP装置につきましても、当中間期300mm対応機種「A-FP-310」を中心に、売上が大幅に伸長しました。これは、当社のCMP装置のコンセプトや構造の優位性がお客様に浸透し高く評価された結果で、今後一層の成長が期待されます。

- (b) 研究開発につきましては、300mmウェーハへの移行や微細化が進展するなかで、市場ニーズに適合する次世代装置のタイムリーな開発に注力しております。

ダイシングマシンでは、浜松ホトニクス株式会社と業務提携し、同社が開発したステルスダイシング技術を使って、ウェーハ表面に損傷を与えず、洗浄不要、完全ブレードレスで、チップ分割を行う新型レーザダイシング装置「MAHOHDICING MACHINE」の開発を進め、当中間期に初めて市場投入を行いました。

CMP装置につきましては、2004年6月に「A-FP」シリーズの機能拡大とラインアップの充実を行い、新たに「ChaMP」シリーズとして販売を開始しました。

子会社の株式会社リープルが開発中の100nm～35nmの微細回路製造用転写装置である「LEEPL転写装置」は、複数のユーザーとのコラボレーションを進め、本格的評価を行っています。

B. 計測機器部門

- (a) 計測機器部門につきましては、国内の景気が上向く中、ユーザーニーズを確実に受注に取込む営業努力により、国内・輸出とも売上を伸ばすことができ、当中間期の受注高は84億40百万円（前中間期比7.5%増）売上高は86億49百万円（同17.8%増）と大きく伸長しました。生産面ではコストダウンに注力し、営業利益は19億64百万円（同32.5%増）と増益を達成しました。

汎用計測機器では、2003年度に市場投入したカールツァイス社の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合した「ザイザックスSVA」シリーズがお客様のニーズに合った製品として引き続き高い評価を受け、販売が大きく伸びました。

リニアモータ採用で世界最高精度と低振動を実現した表面粗さ形状測定機「サーフコムシリーズ」は、各ユーザーのJIS2001適用の動向に伴い需要が急増し、売上が大幅に伸長しました。また、高精度で好評の真円度測定機「ロンコムシリーズ」の売上も堅調に推移しました。

自動計測機器は、自動車産業の設備投資が活発であったことを反映し、自動車の部品生産ライン等で使用される「パルコムシリーズ」などが好調でありました。また新製品の「ATC振れ測定システム」も多くのユーザーに標準採用されました。

- (b) 研究開発につきましては、カールツァイス社製の高精度アクティブスキャニング方式を採用したCNC三次元座標測定機の新シリーズ「ザイザックスSVA fusion」を開発し、2004年4月より販売を開始しました。この装置は、様々な測定物に対して高精度の寸法測定のみならず、形状検査や位置検査を1台で可能にし、測定・検査時間を大幅に短縮します。

また、新開発の検出機を採用し、高いコストパフォーマンスを実現した表面粗さと輪郭形状を同時に測定できる表面粗さ輪郭形状統合測定機「SARFCOM 2000 DX」を、2004年6月より販売開始いたしました。

[新工場建設について]

半導体社および計測社の両カンパニーが、八王子と土浦において、2004年7月新工場の建設に着手いたしました。両新工場とも2005年3月竣工を予定しています。

半導体社の新工場は、好調な市況の下、フローバ・ダイサ等の既存製品やポリッシュ・グラインダ、CMP装置等の新規参入製品のいずれもが受注・売上が順調に拡大していることから各製品の生産能力の増強を図るものです。計測社の新工場も、国内景気の堅調に伴い、計測製品の受注・売上が着実に伸長していることに対応するものです。

[利益配分について]

当中間期の配当につきましては、前述の利益配分の基本方針から、当初予定どおり、一株当たり15円とすることといたしました。

次期の見通し

[業績全般および各部門の概況]

A．半導体製造装置部門

2004年度下期の半導体市場は、5月時点の見込に比して約1四半期早く調整が始まっており、但しこの調整の底は浅く、基調としては第3世代携帯電話・デジタル家電の需要増加や車載デバイスの伸長などから堅調に推移していくものと予想しています。半導体メーカーの設備投資も、300mmウェーハ関連投資の本格化などにより、底固いと思われれます。

当社は、2004年度下期の半導体製造装置部門の経営環境について、10～12月を中心に、シェアの高いウェーハプロービングマシン、ウェーハダイシングマシンなどの既存製品の売上が減少することは避けられないと考えています。しかしながら、ウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ、CMP装置の新規参入製品は、ユーザーからの高い評価を得て、マーケットシェアを拡大中であり、上期比着実な売上増を予想しております。

このような状況を反映させて、半導体製造装置部門の2004年度下期の売上高は、278億円と予想しています。2004年度通期の売上高は、645億円（前期比37.1%増）となる見込です。

B．計測機器部門

計測機器部門につきましては、2004年度下期は、引き続き国内の自動車関連をはじめとする各ユーザーから堅調な需要が見込まれますし、海外も、アジア地域を中心に需要の増加が期待されます。

かかる状況下、お客様のニーズを的確に把握し受注に繋げるとともに、昨年から今年にかけて発売した高機能の新規参入製品も販売増に寄与し、2004年度下期売上高は79億円、2004年度通期の売上高は、165億円（前期比7.9%増）を予定しています。

以上のような予測の下、2004年度下期の連結売上高は357億円と予定し、2004年度通期の売上高は、810億円（前期比29.9%増）、連結経常利益135億円（同153.3%増）、連結当期純利益70億円と予想しております。

[利益配分について]

期末配当金につきましては、上記業績見通しおよび前述の利益配分に関する基本方針に従い、安定的な配当を継続することとし、従来同様一株当たり15円（中間配当金と合わせ通期では一株当たり30円）を予定しております。

(2) 財政状態

当中間期末における現金及び現金同等物は、前期末より20億円減少し、101億円となりました。当中間期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは55億円の収入となりました。これは主に税引前利益（78億円）、減価償却費（14億円）、売上債権の増加（34億円）、たな卸資産の増加（41億円）、および支払債務の増加（53億円）などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは8億円の支出となりました。これは設備投資支出（7億円）などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、68億円の支出となりました。これは主に、短期借入金の返済（41億円）、長期借入金の実行（7億円）、長期借入金の返済（30億円）および配当金の支払（5億円）などによるものであります。

当中間期の営業キャッシュフローは、好調な売上・収益を反映して、55億円のプラスとなりました。今後も新製品の売上拡大や利益計上などにより、営業キャッシュフローのプラスが見込まれ、より良い財務状況を構築できる見込です。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

	平成15年9月期	平成16年3月期	平成16年9月期
自己資本比率（％）	37.2	30.8	34.1
時価ベースの自己資本比率（％）	140.2	138.6	118.2
債務償還年数（年）	18.1	7.9	2.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	11.1	19.7	42.5

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

注1．指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

注2．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しています。

注3．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

将来の事象に係る記述に関する注意

この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内および諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、ならびに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高および利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

4. 比較中間連結貸借対照表

当中間期（平成 16 年 9 月 30 日現在）

前中間期（平成 15 年 9 月 30 日現在）

前 期（平成 16 年 3 月 31 日現在）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

科 目	当中間期	前中間期	前 期	科 目	当中間期	前中間期	前 期
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	75,001	60,512	70,944	流 動 負 債	34,014	40,088	33,285
現金及び預金	10,177	7,403	12,269	支払手形及び買掛金	23,233	10,976	17,574
受取手形及び売掛金	30,248	17,940	26,554	短期借入金	1,365	18,795	5,543
たな卸資産	33,407	34,112	29,196	一年以内返済予定 長期借入金	3,731	5,379	4,311
未収消費税等	377	-	64	一年以内償還予定社債	200	200	200
繰延税金資産	373	416	2,289	未払法人税等	1,323	381	756
その他流動資産	468	676	610	賞与引当金	697	643	646
貸倒引当金	50	37	40	その他流動負債	3,462	3,712	4,252
固 定 資 産	23,309	29,799	23,948	固 定 負 債	28,466	14,652	30,301
（有形固定資産）	（12,600）	（15,501）	（12,847）	社 債	19,750	1,950	19,850
建物及び構築物	5,140	5,488	5,342	転換社債	51	51	51
機械装置及び運搬具	2,919	3,665	3,022	長期借入金	4,491	8,823	6,297
工具器具備品	902	817	843	退職給付引当金	3,521	3,293	3,498
土 地	2,917	2,919	2,919	役員退職慰労引当金	604	486	557
建設仮勘定	719	2,609	719	繰延税金負債	47	47	48
（無形固定資産）	（ 3,146）	（ 7,097）	（ 3,756）	負 債 合 計	62,480	54,741	63,587
ソフトウェア	2,673	6,453	3,199				
その他無形固定資産	472	644	557	少 数 株 主 持 分	2,299	1,949	2,122
（投資その他の資産）	（ 7,562）	（ 7,200）	（ 7,343）				
投資有価証券	3,449	2,981	3,311	資 本 の 部			
長期貸付金	454	380	381	資 本 金	7,392	7,199	7,199
繰延税金資産	3,057	3,315	3,109	資 本 剰 余 金	12,017	11,806	11,806
その他の投資	614	569	554	利 益 剰 余 金	14,153	14,876	10,273
その他の資産				その他有価証券評価 差額金	41	190	57
貸倒引当金	13	46	12	為替換算調整勘定	16	23	105
繰 延 資 産	0	0	0	自 己 株 式	58	48	49
社債発行差金	0	0	0	資 本 合 計	33,530	33,621	29,183
資 産 合 計	98,311	90,311	94,893	負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	98,311	90,311	94,893

5 . 比較中間連結損益計算書

当中間期（平成16年4月1日～平成16年9月30日）

前中間期（平成15年4月1日～平成15年9月30日）

前 期（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

科 目		当中間期	前中間期	前 期
経常 損益 の部	営業 売上高	45,340	25,909	62,324
	売上原価	30,847	19,910	46,531
	売上総利益	14,493	5,998	15,793
	販売費及び一般管理費	(6,336)	(4,652)	(9,846)
	販売費	4,850	3,523	7,483
	一般管理費	1,485	1,128	2,362
	営業利益	8,157	1,345	5,947
	営業外収益	(323)	(94)	(146)
	受取利息及び受取配当金	31	14	23
	その他	292	79	122
営業外費用	(185)	(438)	(765)	
支払利息	142	153	278	
その他	43	285	486	
経常利益	8,295	1,001	5,328	
特別 損益 の部	特別利益	(184)	(198)	(380)
	投資有価証券売却益	68	66	198
	その他	115	132	182
	特別損失	(583)	(205)	(9,772)
	たな卸資産評価損及び廃却損	574	-	3,491
	固定資産除却損	-	-	2,216
	販売用ソフトウェア廃却損	-	-	3,423
	その他	9	205	641
税金等調整前中間純利益又は当期純損失	7,895	994	4,064	
法人税、住民税及び事業税	1,207	372	1,044	
法人税等調整額	2,001	264	1,598	
少数株主持分利益	232	98	273	
中間純利益又は当期純損失	4,454	259	3,783	

6. 比較中間連結剰余金計算書

当中間期（平成16年4月1日～平成16年9月30日）

前中間期（平成15年4月1日～平成15年9月30日）

前期（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

科 目	当中間期	前中間期	前 期
(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高	11,806	11,806	11,806
資本剰余金増加高	211	-	-
1. 新株引受権の権利行使による増加高	211	-	-
資本剰余金減少高	-	-	-
資本剰余金中間期末(期末)残高	12,017	11,806	11,806
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高	10,273	15,191	15,191
利益剰余金増加高	4,454	259	-
1. 中間純利益	4,454	259	-
利益剰余金減少高	574	573	4,917
1. 当期純損失	-	-	3,783
2. 配当金	560	560	1,120
3. 取締役賞与金	14	12	12
利益剰余金中間期末(期末)残高	14,153	14,876	10,273

7. 比較中間連結キャッシュ・フロー計算書

当中間期（平成16年4月1日～平成16年9月30日）

前中間期（平成15年4月1日～平成15年9月30日）

前期（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

（単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示）

勘定科目	当中間期	前中間期	前期
営業活動キャッシュ・フロー			
税金等調整前中間純利益又は当期純損失	7,895	994	4,064
減価償却費	1,470	1,730	2,749
連結調整勘定償却額	40	40	80
退職給付引当金の増加額	23	186	391
役員退職慰労引当金の増加額	47	25	95
貸倒引当金の増減額	9	4	35
受取利息及び受取配当金	31	14	23
支払利息	142	153	278
有形固定資産除却・売却損	1	0	2,216
投資有価証券・ゴルフ会員権評価損	9	18	84
販売用ソフトウェア廃却損	-	-	3,423
投資有価証券売却益	68	66	198
売上債権の増加額	3,493	1,905	10,612
たな卸資産の増減額	4,105	417	3,150
仕入債務の増減額	5,304	24	6,808
取締役賞与の支払額	14	12	12
その他営業活動による収入又は支出	913	997	1,388
小計	6,317	1,698	5,721
利息及び配当金の受取額	31	14	23
利息の支払額	149	154	290
法人税等の支払額	644	587	883
営業活動キャッシュフロー	5,554	970	4,569
投資活動キャッシュ・フロー			
定期預金の預入	11	10	20
定期預金の払出	10	10	20
投資有価証券の取得	222	0	81
投資有価証券の売却	116	218	474
関係会社出資金	21	-	-
有形・無形固定資産の取得	717	1,157	1,978
有形・無形固定資産の売却	62	340	1,741
貸付金の実行	376	338	356
貸付金の回収	303	14	31
投資活動キャッシュフロー	857	923	167
財務活動キャッシュ・フロー			
短期借入金の減少額	4,178	650	13,877
長期借入金の実行	700	3,800	4,100
長期借入金の返済	3,084	1,341	5,235
社債の発行	-	-	18,000
社債の償還	100	100	200
新株引受権の権利行使	383	-	-
配当金の支払	560	560	1,120
その他財務活動による支出	8	1	3
財務活動キャッシュフロー	6,847	1,145	1,662
現金・現金同等物 換算差額	58	10	16
現金・現金同等物 増減額	2,092	1,182	6,048
現金・現金同等物 期首残高	12,242	6,193	6,193
現金・現金同等物 期末残高	10,149	7,376	12,242

8 . 中間連結財務諸表作成の基本となる事項

1 . 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社(8社)

(株)東精エンジニアリング、(株)トーセシステムズ、(株)アクレーテック・マイクロテクノロジー、(株)アクレーテック・クリエイト、(株)アクレーテック・ファイナンス、(株)リープル、ACCRETECH USA, INC.、ACCRETECH (EUROPE) GmbH

(2) 非連結子会社(8社)

(株)東精ボックス、ACCRETECH(MALAYSIA)SDN,BHD.、ACCRETECH(ISRAEL)LTD.、ACCRETECH(SINGAPORE)PTE LTD.、ACCRETECH MICRO TECHNOLOGIES KOREA CO.,LTD、東精精密設備(上海)有限公司、東精計量儀(平湖)有限公司、TOSEI(THAILAND) CO.,LTD

連結の範囲から除いた理由は、上記8社いずれも小規模会社であり、合計の総資産・売上高・中間純損益及び利益剰余金の金額がいずれも僅少であり、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないためであります。

2 . 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社8社及び関連会社三門峡中原精密有限責任公司については、それぞれ中間連結純損益及び連結利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資については、持分法を適用せず原価法により評価しております。

3 . 連結子会社の中間決算日に関する事項

連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。

4 . 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの……中間連結会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法により算定しています。)

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。

(ロ) たな卸資産

親会社及び国内連結子会社は、商品・製品・材料及び貯蔵品については、先入先出法による原価法、仕掛品については、個別法による原価法であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

親会社及び国内連結子会社は、定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物付属設備は除く)については、定額法によっております。

(ロ) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアは、見込販売数量に基づく方法又は残存有効期間に基づく定額法によっており、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。その他の無形固定資産は、定額法であります。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の日連結会計年度より費用処理しております。

(ニ) 役員退職慰労引当金

役員の退任時に支出が予想される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末支払見込額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

9. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当中間期(平成16年4月1日～平成16年9月30日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益					
(1)外部顧客に対する売上高	36,691	8,649	45,340	-	45,340
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	36,691	8,649	45,340	(-)	45,340
営業費用	30,498	6,684	37,183	(-)	37,183
営業利益	6,192	1,964	8,157	(-)	8,157

前中間期(平成15年4月1日～平成15年9月30日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益					
(1)外部顧客に対する売上高	18,565	7,343	25,909	-	25,909
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	18,565	7,343	25,909	(-)	25,909
営業費用	18,703	5,860	24,563	(-)	24,563
営業利益又は営業損失()	137	1,483	1,345	(-)	1,345

前期(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(単位 百万円:百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益					
(1)外部顧客に対する売上高	47,045	15,279	62,324	-	62,324
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	(-)	-
計	47,045	15,279	62,324	(-)	62,324
営業費用	44,272	12,104	56,377	(-)	56,377
営業利益	2,772	3,174	5,947	(-)	5,947

(2) 所在地別セグメント情報

当中間期 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消却又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	37,664	4,552	3,123	45,340	-	45,340
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	4,513	-	-	4,513	(4,513)	-
計	42,178	4,552	3,123	49,854	(4,513)	45,340
営 業 費 用	34,423	4,516	2,809	41,749	(4,566)	37,183
営 業 利 益	7,755	35	314	8,105	52	8,157

前中間期 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消却又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	22,446	1,863	1,599	25,909	-	25,909
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	2,203	-	-	2,203	(2,203)	-
計	24,650	1,863	1,599	28,112	(2,203)	25,909
営 業 費 用	23,286	2,015	1,539	26,841	(2,277)	24,563
営業利益又は営業損失 ()	1,364	151	59	1,271	74	1,345

前 期 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	日 本	米 国	ドイ ツ	計	消却又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
(1)外部顧客に対する売上高	53,210	5,738	3,375	62,324	-	62,324
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	6,365	-	-	6,365	(6,365)	-
計	59,575	5,738	3,375	68,689	(6,365)	62,324
営 業 費 用	53,804	5,721	3,252	62,779	(6,402)	56,377
営 業 利 益	5,770	16	122	5,909	37	5,947

(3) 海外売上高

当中間期 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	14,429	4,771	3,112	1,943	24,257
連結売上高					45,340
連結売上高に占める海外売上高	31.8%	10.5%	6.9%	4.3%	53.5%

前中間期 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	5,317	1,608	1,952	1,200	10,078
連結売上高					25,909
連結売上高に占める海外売上高	20.5%	6.2%	7.5%	4.7%	38.9%

前 期 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

(単位 百万円 : 百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北 米	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	16,774	5,311	3,838	2,983	28,908
連結売上高					62,324
連結売上高に占める海外売上高	26.9%	8.5%	6.2%	4.8%	46.4%

10. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	当 中 間 期	前 中 間 期	前 期
	自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 9 月 30 日	自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 9 月 30 日	自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日
半導体製造用機器関連事業	37,830	18,393	47,766
計測機器関連事業	8,645	7,366	15,473
合 計	46,476	25,759	63,239

(注) 金額表示は販売価額(消費税抜き)によっております。

(2) 受注実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	当 中 間 期		前 中 間 期		前 期	
	自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 9 月 30 日		自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 9 月 30 日		自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体製造用機器関連事業	38,488	16,617	19,840	8,487	54,653	14,821
計測機器関連事業	8,440	3,356	7,853	2,717	16,635	3,564
合 計	46,929	19,974	27,693	11,205	71,289	18,385

(注) 金額表示は販売価額(消費税抜き)によっております。

(3) 販売実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	当 中 間 期	前 中 間 期	前 期
	自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 9 月 30 日	自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 15 年 9 月 30 日	自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日
半導体製造用機器関連事業	36,691	18,565	47,045
計測機器関連事業	8,649	7,343	15,279
合 計	45,340	25,909	62,324

(注) 金額表示は販売価額(消費税抜き)によっております。

11. 有価証券の時価等

(1) 有価証券の時価等

時価のある有価証券

(単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示)

区 分	当 中 間 期 (平成16年9月30日現在)			前 中 間 期 (平成15年9月30日現在)			前 期 (平成16年3月31日現在)		
	取得原価	中間連結 貸借対照 表計上額	差 額	取得原価	中間連結 貸借対照 表計上額	差 額	取得原価	連結貸借 対 照 表 計 上 額	差 額
その他の有価証券									
(a) 株 式	2,443	2,531	87	2,452	2,145	306	2,328	2,448	120
計	2,443	2,531	87	2,452	2,145	306	2,328	2,448	120

時価のない有価証券

(単位 百万円：百万円未満を切捨てて表示)

区 分	当 中 間 期 (平成16年9月30日現在)	前 中 間 期 (平成15年9月30日現在)	前 期 (平成16年3月31日現在)
	中間連結貸借対照表計上額	中間連結貸借対照表計上額	連結貸借対照表計上額
その他の有価証券			
(a)非上場株式	918	836	862
計	918	836	862

12. 関連当事者との取引

当中間連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)

該当事項はありません。